

FlotTHERM

进行热分析，建立虚拟模型，以及试验在电子设备的物理样机前的设计修改

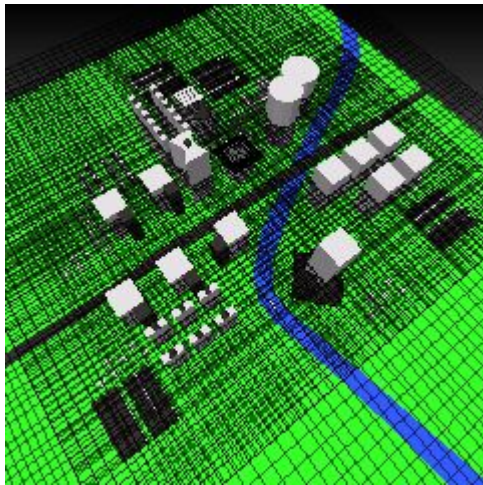
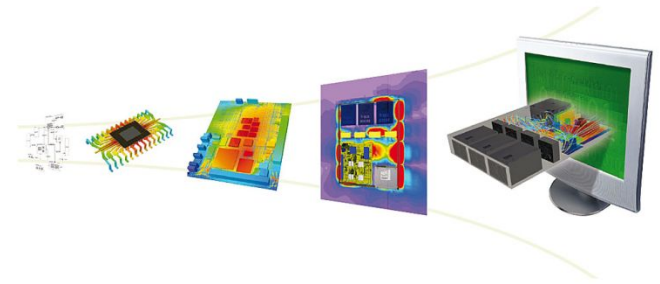
简介

FlotTHERM 采用先进的CFD技术来预测气流，温度，和元器件，电路板，和完整的系统，包括机架和数据中心的热传递。这也是业界最好的与MCAD和EDA软件的集成解决方案。

FlotTHERM是无可争议的世界领先地位的电子热分析，有98%的用户推荐评级。它支持更多的用户，应用实例，图书馆和发表技术论文比任何竞争产品。

加速热设计工作流程

FloTHERM集成了流行的MCAD和EDA工具。它的XML导入功能自动简化建设，解决模型和后处理的结果。FloTHERM的自动顺序优化和DoE能力可以缩短时间达到优化设计，允许它被深深地嵌入在设计流程里。图1



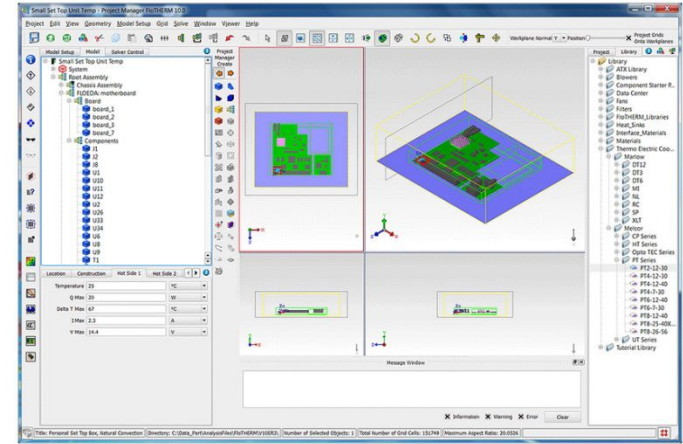
强大的网格划分和快速求解

FloTHERM让工程师专注于设计，提供最准确的结果在工程的时间表内。其SmartParts和structured-Cartesian方法提供了每个网格单元最快的时间解决方案。所述的FloTHERM“localized-grid”技术支持一体匹配，嵌套的，非保形网格接口于不同部分之间的解决方案领域。图2

可用性和智能热模型

积分模型检测中的FloTHERM，用户可以看到哪些对象连接材料，连接到每一个对象的功耗，以及对应的组裝级的功耗。FloTHERM还确定对象是否已建立网格线。

FloTHERM SmartParts代表电子供应商的一个大名单，从IC到电子产品的全机架，简化模型的创建，以尽量减少解决时间，最大限度地提高解决方案的准确性。图3

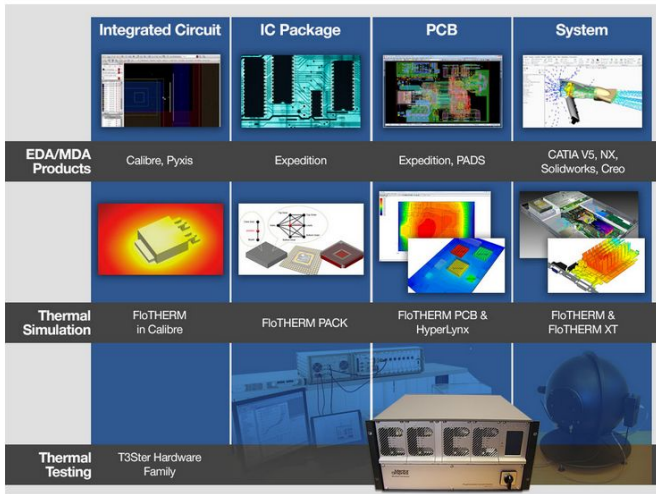


热特性和分析，从组件到系统

结合FloTHERM与T3Ster瞬态热特性的现实世界电子热仿真。由于元件的可靠性，由于热量的问题呈指数下降，使用T3Ster使制造商设计芯片，集成电路，以及优异的散热性能的PCB。他们也可以为下游应用发布可靠的热数据。

设备制造商和系统集成商能够设计出更可靠的产品，避免热引起的故障在整个产品的生命周期。

图4



FlotTHERM XT

从概念设计到制造以CAD为中心的热CFD

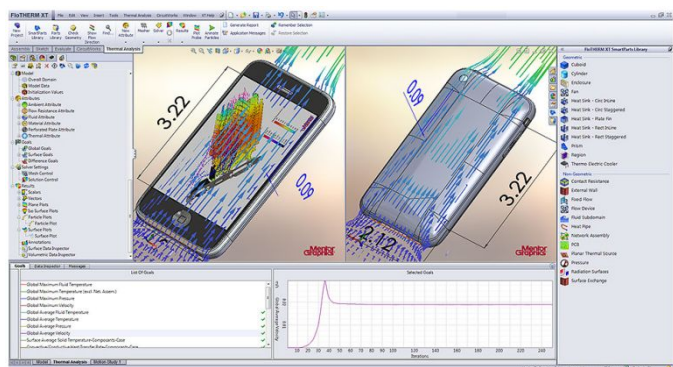
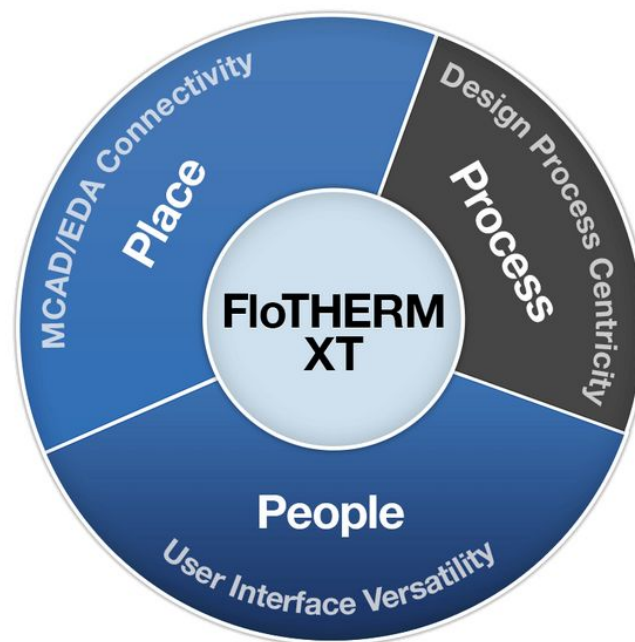
简介

FlotTHERM XT是一个独特的，屡获殊荣的热仿真解决方案，可以在电子设计流程的各个阶段使用 - 从概念设计到制造 - 提高产品质量，可靠性，并缩短产品上市时间。

它采用了电子冷却的DNA市场领先的FlotTHERM热分析软件，以及并行计算流体力学从的FlotEFD（同步CFD）技术。

压缩的电子散热设计过程

FloTHERM XT紧密连合的MCAD和EDA设计流程，并通过至少2个因素相比，传统的通用仿真产品设计减少加工时间。这使得设计和热专家快速有效地到达最佳的解决方案。图5



新的以CAD为中心的热工程方法

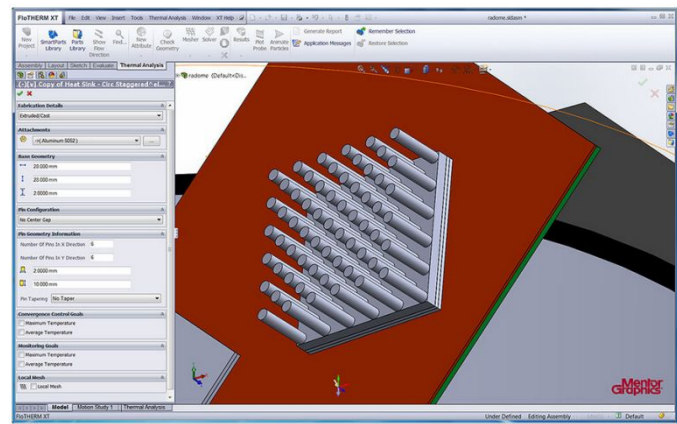
以CAD为中心的用户界面，以及迅速高效的复杂和任意形状的几何形状几何引擎。FloTHERM XT提供CAD连接和先进的CAD建模能力从而大大缩短学习曲线。

图6

快速，准确的模型创建

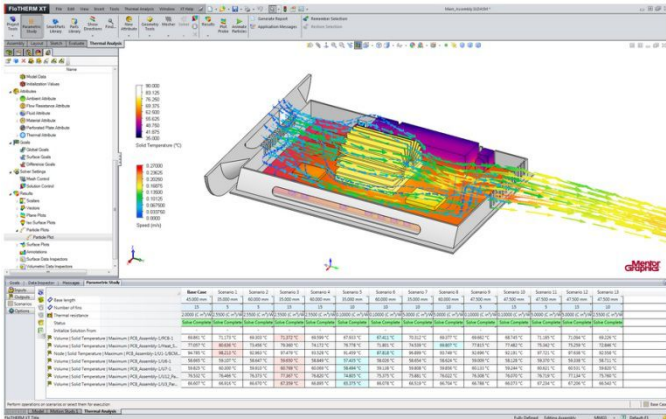
完整的几何和非几何SmartParts和库功能，使用户能够访问全部最常用的部件进行快速和精确的模型创建。

图7



参数研究优化设计

FloTHERM XT的完全集成的环境包括定义，解决和使用几何参数变化分析结果，属性（如材料，热）加上解决方案的参数这显着提高了设计优化过程。图8



先进的EDA接口技术

FloTHERM XT与PCB设计流程的互操作性降低了耗时的数据转换和代价高昂的错误。

它提供了一个简单而直观的直接连接Xpedition和ODB ++接口支持的Cadence，Zuken和Altium。任何电路板和元件布局可以导入并方便地进行修改的位置，大小，方向，形状和转移到建模前的FloTHERM XT。这就是为什么FloTHERM XT是市场唯一，允许工程师用在MDA或EDA世界创建几何毫不费力工作的解决办法。图9

